

< 日本特許・実用新案明細書収録セット >

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

硫酸銅メッキ方法と浴の組成

[公開編] 平成5年～平成12年(8年間) 71点

全文収録 全文公報版 ¥27,700-

既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	既刊関連セットのご案内	年次	点	価格
No,9060	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.11-12	65点	¥24,200
No,8593	"	"	平.9-10	62点	¥23,700
No,8083	"	"	平.7-8	66点	¥29,500
No,7795	"	"	平.5-6	63点	¥24,700
No,7552	"	"	平.3-4	57点	¥23,000
No,7163	"	"	平.1-2	61点	¥21,100
No,6577	"	"	昭.59-63	64点	¥21,500
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11	81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11	75点	¥29,700
No,8868	"	半導体ウェーハのメッキ方法と工程	平.5-11	103点	¥35,000
No,8600	"	多層装飾メッキ方法と工程	平.5-10	80点	¥30,000
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-9	65点	¥28,000
No,8503	"	装飾用パラジウムメッキ方法	平.5-9	53点	¥20,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-8	68点	¥29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-8	62点	¥26,800
No,8290	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.5-8	62点	¥24,800
No,8938(B)	"	チタンのメッキ加工方法	平.7-11	55点	¥21,600
No,7942(B)	"	"	平.3-6	50点	¥19,700
No,8938(A)	"	チタンの着色加工方法	平.7-11	57点	¥22,400
No,7942(A)	"	"	平.3-6	67点	¥24,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、FAX, 郵便にてお送りください。(お電話でも承ります)
 [原本コピーはB5サイズ・目次製本済みです。2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会 社 名	ご 注 文 内 容
	ニュースガイド No, _____
	全文公報版
所 属 部 署	題 名
担 当 者 名	合計 ¥ _____
	() Fax ()
住所 〒 _____	

硫酸銅メッキ方法と浴の組成 No, 9088

[公開編]平成5年～平成12年 71点

全文公報版

¥27,700

日本特許公開平成5年

- 1 電気銅めっき法 住友金属鉱山(株)
- 2 電気銅めっき液 石原薬品(株)
- 3 セラミック配線板の製法 松下電工(株)
- 4 ボンディングパッド形成方法 ヤマハ(株)
- 5 配線板の製造法 日立化成工業(株)
- 6 凹版印刷用基材及びその製造方法 凸版印刷(株)
- 7 超電導線の銅安定化層を電気メッキ法により形成する方法 古河電工(株)
- 8 化学銅めっき浴 (株)日立s/s
- 9 筆記具 奥野製薬工業(株)
- 10 ホルマリンを用いない化学銅めっき方法 (株)日立s/s
- 11 グラビアロールの銅めっき マデアン-ロ-コ Inc.
- 12 無電解銅鍍金の前処理液 日立化成工業(株)

日本特許公開平成6年

- 13 プリント配線板の硫酸銅めっき方法 富士通(株)
- 14 硫酸銅めっき方法 "
- 15 シアン化物を含まない1価金属のメッキ溶液 リーロナル Inc.
- 16 薄膜多層配線板及びその製造方法 イビデン(株)
- 17 パターンメッキ方法 旭化成工業(株)
- 18 線条材の銅メッキ方法 (株)神戸製鋼所
- 19 酸性銅電気めっき浴の機能的液体添加剤 イント・オーエムアイ Inc.
- 20 無電解銅めっき浴自動管理システム 日本ケミコン(株)
- 21 " "

日本特許公開平成7年

- 22 電気銅めっき液及びこれを用いためっき方法 住友金属鉱山(株)
- 23 電気銅めっき液 "
- 24 銅電析用メッキ液 住友金属工業(株)
- 25 酸性銅めっき浴及びこれを使用するめっき方法 奥野製薬工業(株)
- 26 アルミニウムとアルミニウム合金へのメッキ方法及び電解液 千代田機器販売(株)
- 27 希土類鉄窒素化合物磁石粉末の製造方法およびこの方法により得られる磁石粉末 住友金属鉱山(株)
- 28 配線板の製造方法 日立化成工業(株)
- 29 " "
- 30 アルミダイカストのめっき層構造 スズキ(株)
- 31 非シアン系銅 - 亜鉛電気めっき浴、これを用いたプリント配線板用銅箔の表面処理方法及びプリント配線板用銅箔 日本電解(株)
- 32 炭素繊維の銅メッキ方法 (株)ジャパンエナジー
- 33 無電解銅めっき液中の添加剤の濃度測定法 日立化成工業(株)

日本特許公開平成7年

- 34 有機チオ化合物 上村工業(株)

日本特許公開平成8年

- 35 プリント基板のめっき方法 (株)荏原電産
- 36 フレキシブル基板 ミツミ電機(株)
- 37 " "
- 38 半導体ウェハのめっき方法 日本電装(株)
- 39 銅箔の表面粗化処理方法 古河サキト・フォイル(株)
- 40 ナノ結晶金属 クイーンズ・エナジー

日本特許公開平成9年

- 41 セラミックへのメッキ方法および誘電体共振器 アルプス電気(株)
- 42 多層プリント基板の製造方法 (株)荏原電産
- 43 電解銅箔の製造方法 日鉱グ-ルト・フォイル(株)
- 44 銅メッキ液 (株)全研
- 45 銅めっき線の製造方法 東京特殊電線(株)

日本特許公開平成10年

- 46 電解液の浄化方法 (株)ジャパンエナジー
- 47 電解銅箔及びその製造方法 "
- 48 銅被覆炭素粉末、その製造方法、および導電部材の製造方法 (株)河口商店
- 49 弗素樹脂体表面への金属導電層形成方法 東京特殊電線(株)
- 50 一次めっき用無電解めっき液 イビデン(株)
- 51 片面銅めっき鋼帯の製造方法 日新製鋼(株)
- 52 電解銅箔の製造方法 (株)ジャパンエナジー
- 53 銅箔の表面処理方法 福田金属箔粉工業(株)

日本特許公開平成11年

- 54 電解銅めっき液及びこれを用いた電解銅めっき方法 日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ(株)
- 55 銅めっき方法及び銅めっき液 (株)ジャパンエナジー
- 56 ペースト状析出防止剤およびペースト状析出防止法 荏原ユ-ジライト(株)
- 57 多層配線基板とその製造方法 住友金属工業(株)
- 58 プリント配線板用銅箔及びその製造方法 古河サキト・フォイル(株)
- 59 電気めっき方法 アプライト・マテリアルズ Inc.
- 60 複合銅箔およびその製造方法並びに該複合銅箔を用いた銅張り積層板およびプリント配線板 三井金属鉱業(株)

日本特許公開平成12年

- 61 硫酸銅めっき液及びこれを用いた電解めっき方法 日本エレクトロプレイング・エンジニアーズ(株)
- 62 銅めっき方法及び銅めっき液 (株)ジャパンエナジー
- 63 銅ダマシム配線用めっき液 荏原ユ-ジライト(株)
- 64 充填されたプラインドビアホールを有するビルトマッププリント配線板の製造方法 日本リーロナル(株)

- 以下7点省略 -

題名	出願人	年度
日本特許公開		
65 電解処理方法、電解液および半導体装置の製造方法	ソニー(株)	平成12年
66 針状結晶形成用電気銅めっき液および針状被膜の形成方法	荏原ユージライト(株)	"
67 銅配線膜の形成方法	(株)神戸製鋼所	"
68 電気銅メッキ浴及び当該メッキ浴により銅配線形成した半導体デバイス	石原薬品(株)	"
69 電気銅めっき液	(株)ジャパンエナジー	"
70 電解銅箔の製造方法、電解銅箔、網張り積層板およびプリント配線板	三井金属鉱業(株)	"
71 プリント配線板の製造方法	イビデン(株)	"

